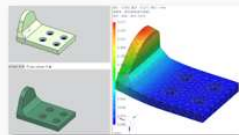
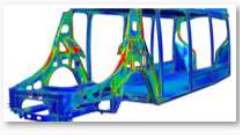
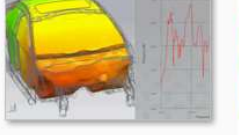
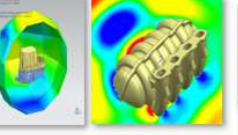
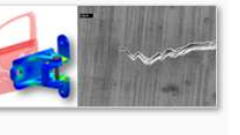
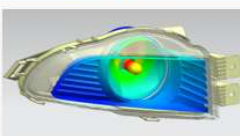
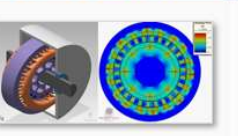
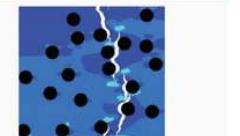
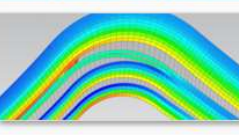
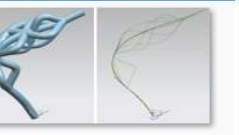
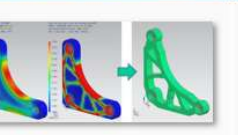
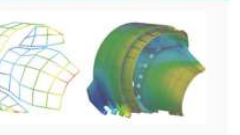


Simcenter 3D

Simcenter 3Dは、CAD機能を実装しCAD,CAEがシームレスに繋がるCAD統合CAEソフトウェアです。CAD形状を変更すれば、CAE形状も変更されるため、対策案検討、最適化などが容易に行えます。また以下4つの特長をもっています。

多種多様な解析をカバーし、1つのGUIで操作！

Simcenter 3Dは多種多様な解析をカバーしており、その操作は1つのGUIに統一されています。異なる解析でも共通操作が多く、解析種類別の異なる操作は少ないシステムです。

CAD&プリポスト	構造解析	振動解析	音響解析	疲労耐久
				
機構解析	熱解析	流体解析	電磁場解析	材料解析
				
積層複合材料	アディティブ	フレキシブルパイプ	トポロジー最適化	コリレーション
				

多種多様な解析を繋ぐ！ 複合領域の解析

異なる解析ソルバーがシームレスに繋がれているため、連成解析が容易となっており、実現象により近い解析を行うことができます。



Simcenter 3D

多種多様な解析を最適化！

設計目標(質量、体積など)に対して、制約(応力、強度など)を満たしつつ、最適条件を探索します。アルゴリズムの選択、チューニングなどは必要なく、反復回数を設定するだけで探索アルゴリズムSHERPAが少ない計算回数で効率的に探索します。

Simcenter 3D パラメータ:

- 形状, 材料選択, 特性値...

Simcenter 3D 結果:

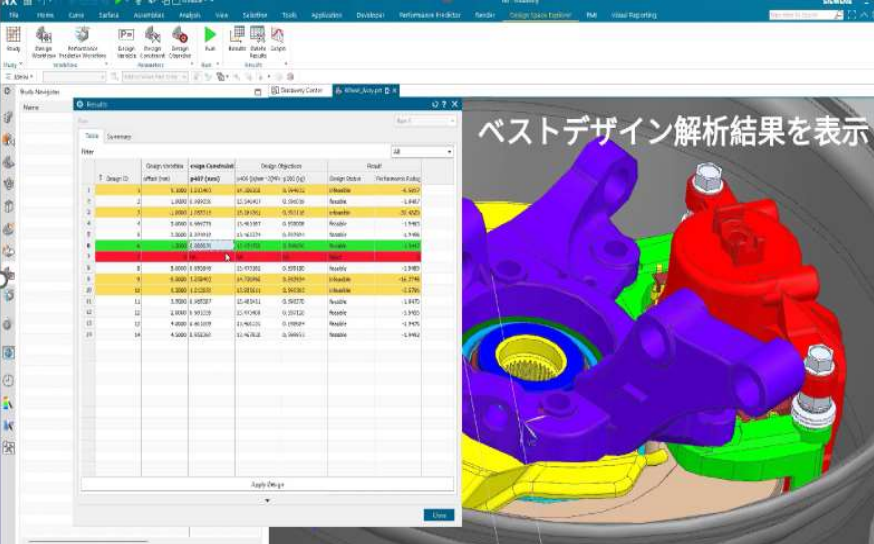
- すべての解析結果

Simcenter 3D Design Space Exploration Tool:

- CAEプロセスの自動化
- 高速な設計空間探索アルゴリズムSHERPA

最適化例 (右動画)

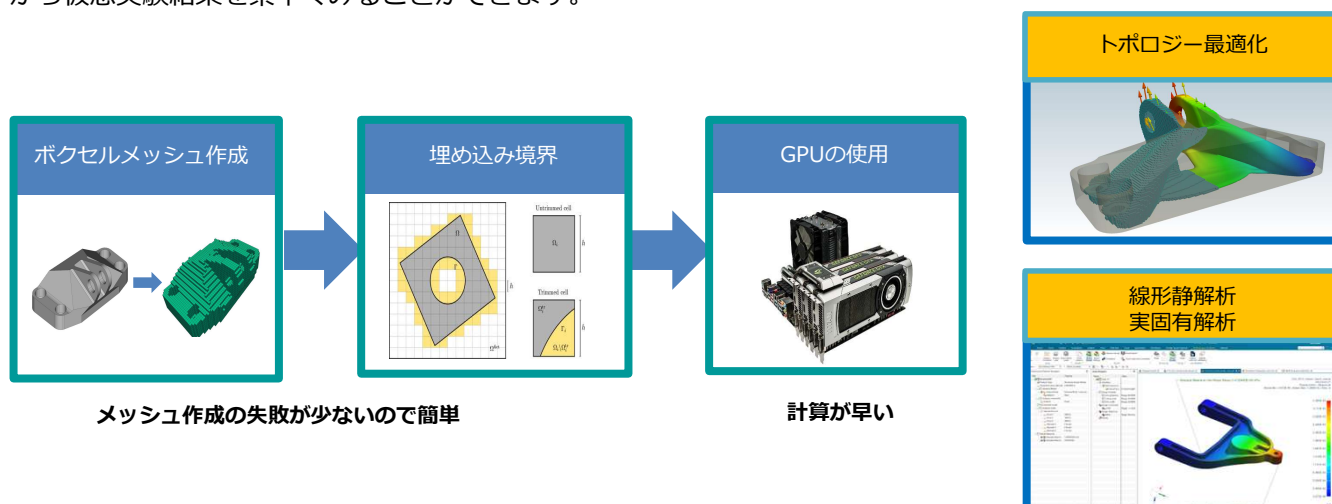
パラメータ: 荷重箇所近くの円筒面直径
 目的: 軽量化 応力最小化
 制約: 変位1mm以下



ベストデザイン解析結果を表示

簡単！早い！設計とCAEの融合を可能とするソリューション

設計者が、設計しながら解析するのではなく、**解析しながら設計**することをターゲットに、簡単に速くできる解析が用意されています。トポロジー最適化では形状のヒントを、線形静解析、実固有値解析では形状変更しながら仮想実験結果を素早くみることができます。



※記載されている会社名、商品名はそれぞれ各社の登録商標です。

製品・サービスに関するお問い合わせ

デジタルプロセス株式会社
 デベロップメントエンジニアリングサービス部
 E-mail: dipro-sc3d-prom@cs.jp.fujitsu.com

デジタルプロセス株式会社

本社/川崎オフィス：
 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 Fujitsu Uvance Kawasaki Tower
 拠点：厚木オフィス/名古屋オフィス/豊田オフィス/浜松オフィス/大阪オフィス/
 長野オフィス/福岡オフィス
 HP www.dipro.co.jp